

特点

1. 中心放大门极结构
2. 平板型陶瓷管壳封装
3. 低通态和开关损耗

典型应用

- | | | |
|------------|-----------|-----------------------|
| 1. 大功率变流器 | $I_F(AV)$ | 500A |
| 2. 焊接设备 | V_{RRM} | 1600V |
| 3. 电机控制和驱动 | I_{FSM} | 7KA |
| | I^2t | $250 \cdot 10^3 A^2S$ |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			$T_J(^{\circ}C)$	最小	典型	最大	
$I_F(AV)$	正向平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=120^{\circ}C$	150			500	A
$I_F(AV)$	正向平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=55^{\circ}C$	150			1202	V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}, V_{RSM} = V_{RRM} + 100V$	150		1600		mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_R = V_{RRM}$	150				KA
I_{FSM}	正向不重复峰值电流	10ms 底宽, 正弦半波	150			1000	$A^2 \cdot 10^3$
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6V_{RRM}$	150			40	V
V_{FO}	门槛电压		25			7	mΩ
r_F	斜率电阻		150			250	V
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{TM}=1500A, F=15KN$	150			1.06	A
I_{rm}	反向恢复电压	$I_{TM}=600A, \text{tp}=1000\mu s,$	150			0.31	μs
t_{rr}	反向恢复电流	$di/dt=-20A/\mu s,$				1.8	μC
Q_{rr}	恢复电荷	$V_R=50V$					
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180°正弦波, 双面散热; 压紧力15KN				0.040	$^{\circ}C / W$
F_m	安装力			10		20	KN
T_{stg}	存储温度			-40		160	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

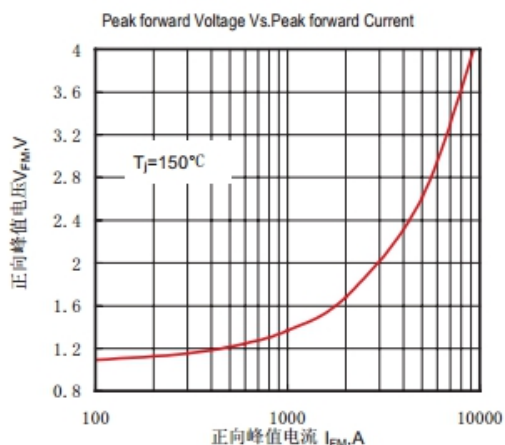


Fig.1 正向伏安特性曲线

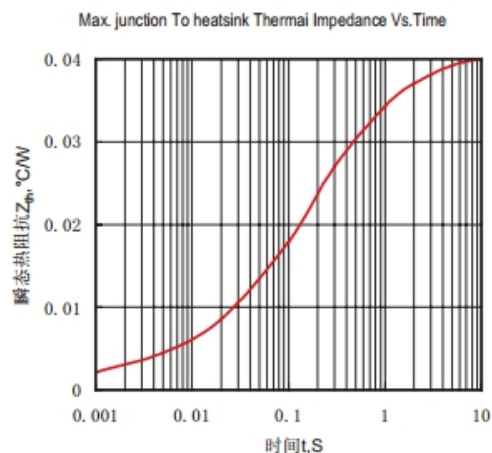


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

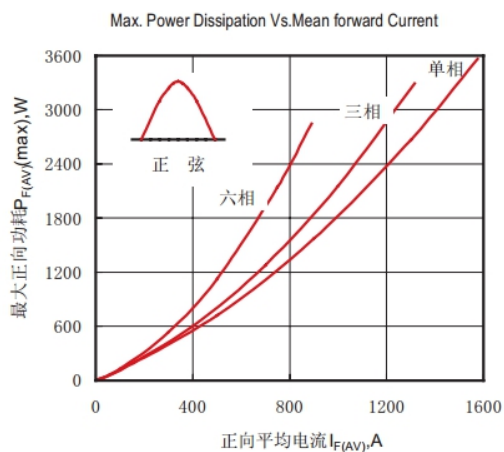


Fig.3 最大功耗与正向平均电流关系曲线

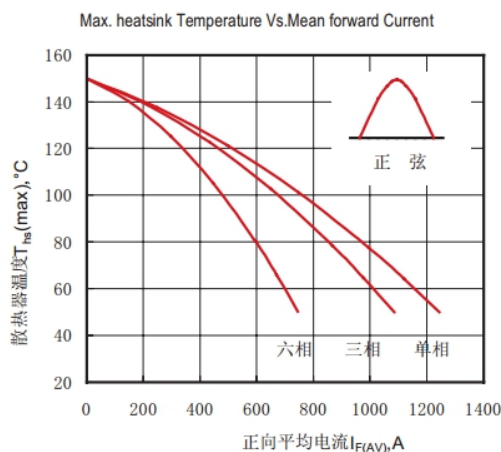


Fig.4 散热器温度正向平均电流 关系曲线

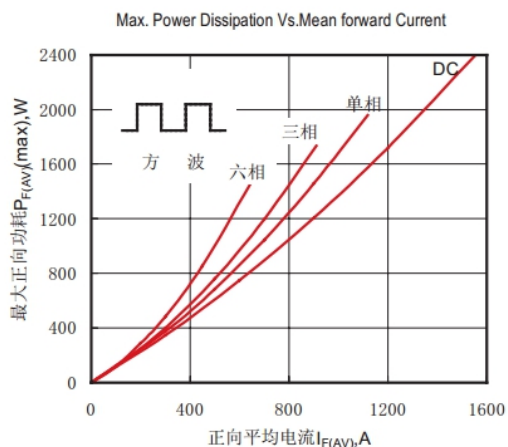


Fig.5 最大功耗与正向平均电流关系曲线

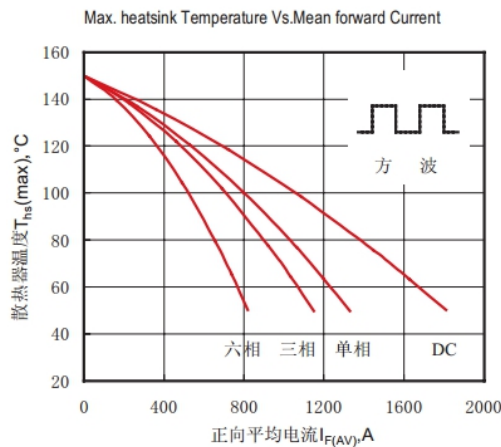


Fig.6 散热器温度正向平均电流 关系曲线

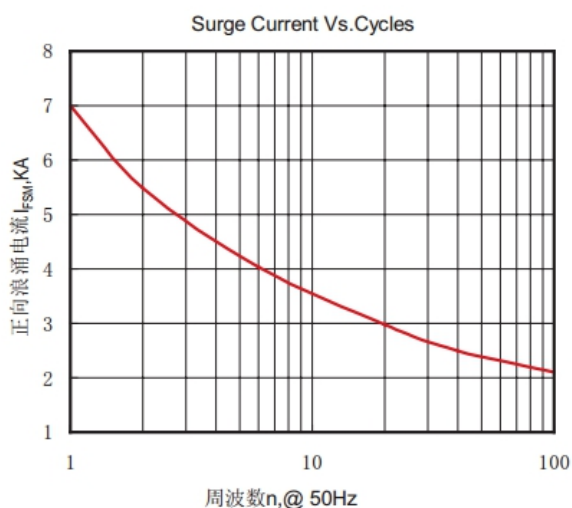


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

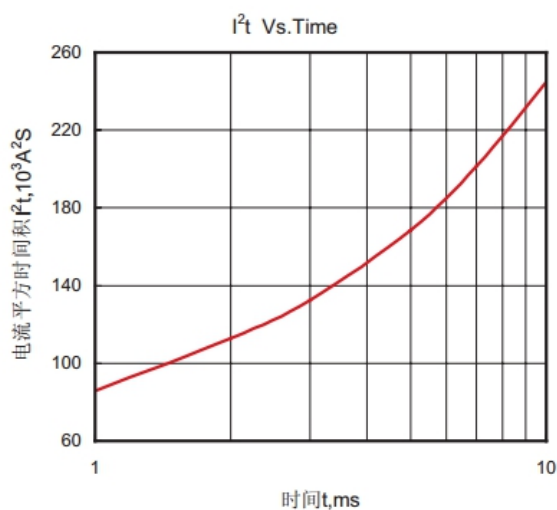


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图

